

第 1 章 《材料科学基础》考研专用笔记

32 种点群 23 种晶系属于立方
立方有六次轴

§1 晶体学

1	2	3	4	6	回转对称轴	} 实际 10 种 对称元素	} 对称元素 26 种
m	$(\bar{1})$				对称面		
Z	$(\bar{1})$				对称中心		
$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{6}$	回转-反演轴	} 实际 16 种 对称元素	}
a	b	c	n	d	滑移面(线)		
2_1	3_1	3_2	4_1	4_2	6_5		

每种对称型最多导出 7 个单形
32 种点群 \rightarrow 47 种单形 \rightarrow 230 种空间群
7 种晶系 —— 分类依据: 晶胞外形即棱边长度之间的关系和晶轴夹角情况
14 种布拉维点阵 —— 分类依据: 阵点在空间的排列状况

§2 晶体化学

- 金属键: 金属键与金属键以 $X=2$ 分开。
- 金属键 $\Delta X < 0.5$; 离子键 $\Delta X \geq 1.7$; 过渡价键 $\Delta X < 0.7$, 极性 $0.7 < \Delta X < 1.7$
- 极性共价键通常在 H 与 Cl, N, O, F 之间形成。CH₄ 不能形成氢键, Cl, N, O, F 能形成氢键。
- 键能: 分散原子结合为晶体的过程中释放的能量。
- 原子吸引作用是长程力, 起因: 异性电荷之间的库仑力。吸引能 $V_a = \frac{-Z_1 Z_2 e^2}{r}$
原子排斥作用是短程力, 起因: 同性电荷间库仑力和原子实间电子排斥力。
- 所有固体, 排斥力相同 $F_r = -\frac{b}{r^{12}}$;
不同固体, 吸引力依赖于键合类型而不同。总体上 $F_a = \frac{a}{r^m}$ m 一定大于 n
- 范德瓦耳斯半径: 分子晶体中两个最近原子间总距离等于其键长的一半。
共价半径: 具有相同原子的双原子分子中两个原子间共价键长的一半。
离子半径: $r_a + r_c = r_0$ (长距离两原子间)
金属: $r_{metal} = \frac{d_{m-m}}{2}$, 其中 d_{m-m} 为键长

晶体的结构

晶胞原子数	晶面	密排面堆垛	原子配位数 配位数 配位数 配位数	r_B/r_A	配位数	配位数	举例
面心立方(A ₁)	4	{111}	ABCABC... 配位数 配位数 配位数 配位数	0.225 0.414	12	0.74	Al, r-Fe Cu Ag, Au
体心立方(A ₂)	2	{110}	配位数 配位数	0.29 0.15	8	0.68	α-Fe, W 所有IA族
密排立方(A ₃)	6	{0001}	ABAB... 配位数 配位数 配位数 配位数	0.225 0.414 c/a=1.633 锐角 c/a=2 $\sqrt{3}$	12 6+6	0.74	Be Mg Zn Cd

r_c/r_a	配位数	晶面	举例
0-0.155	2	线性	CO ₂
0.155-0.225	3	三角	B ₂ O ₃
0.225-0.414	4	四面体	SiO ₂
0.414-0.732	6	八面体	TiO ₂
0.732-1.0	8	立方体	CsCl

共价晶体

1. 金刚石结构: C, Si, Ge, Sn; As, Sb, Bi; 层状(片状)结构, 与3个原子配位, 键角小于120°, 有褶皱; S, Se, Te — 密排链结构

2. 面心立方ZnS(闪锌矿): Zn面心立方结构与S面心立方结构沿对角线错开 $\frac{1}{4}(a+b+c)$; 配位数都为4; ABCABC...; 金刚石结构属于立方ZnS型

方石英(白石英)属于金刚石结构。

六方ZnS(纤锌矿): Zn和S在简单六方格子在a, b轴重合, c轴错开 $\frac{1}{8}$ 或 $\frac{7}{8}$ 或 $\frac{5}{8}$ 。坐标为(0,0,0)和($\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$) 则Z为($0, 0, \frac{5}{8}$) ($\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{8}$)

配位数都为4。纤锌矿属六方ZnS型。注: 方石英密度略比纤锌矿高

离子晶体:

一. 泡林规则

(一) 静电价规则: 一个阳离子与相邻阴离子静电键强 $EBS = Z/\sqrt{r}$ 键数

(二) 共价键数愈大, 尤其共价键愈大, 愈不稳定.

(三) 高电价和低配位正离子, 尽可能相互远离

(四) 节约规则: 所有相同离子和周围配位关系键位相同, 即正负电荷数趋于最值.

二. NaCl 晶体由于键位处于最小值, 而配位数很大, 故最稳定. 配位数 6.

2. BaTiO_3 (钙钛矿型): 假立方体晶系结构, 低洼时转变为斜方晶系.

Ba 和 O 形成最密堆积. (因为尺寸很接近, 电负性相近); O 只能形成八面体空隙, 且只有正常结构的 $\frac{1}{3}$. Ti 位于八面体空隙中. 每八面体从共角堆积在空间中排列.

补充: AX 和 AX_2 两种化合物即使满足 A 仅被 X 包围, 也不能排成最密堆积, 而 AX_3 能, 例如 Ba-O_3 , Ba 仅被 O 所包围.

3. CsCl 作体心立方结构对称. Cs 离子和 Cl 离子各一套简单立方格子, 以 $\frac{1}{2}(a+b+c)$ 相隔穿插. 配位数为 8.

4. 尖晶石 (MgAl_2O_4): O^{2-} 作面心立方最紧密堆积排列; O^{2-} 周围最近有一个 Mg^{2+} 和三个 Al^{3+} ; O^{2-} 是四面体空隙 $[\text{MgO}_4]$ 和三个 $[\text{AlO}_4]$ 配位八面体的公共顶角; 晶胞中含有 8 个 "分子"; Mg^{2+} 占有全部四面体空隙 $\frac{1}{8}$, Al^{3+} 占八面体空隙 $\frac{1}{2}$.

5. 萤石 (CaF_2): 简单立方, $\frac{1}{2}$ 立方体空隙. 金红石 (TiO_2): 扭曲的八面体最密堆积, $\frac{1}{2}$ 八面体空隙.

硅酸盐晶体

根据 SiO_2 四面体排列方式分: 岛状; 链状 (单链、双链)、层状、三维骨架结构.

岛状: $\frac{\sum \text{OR}}{N_{\text{Si}}} \geq 4$ 单链 $\frac{\sum \text{OR}}{N_{\text{Si}}} = 2$ 双链 = 1.5 层状 = 1.0 骨架 < 1.0

网同晶取代条件: ① 离子(或原子)尺寸差必须在 15% 以内; ② 离子电荷差不易太大 ③ 取代离子与原有配位数结构

链状硅酸盐: 每个 $[\text{SiO}_4]$ 有一个桥氧, 以 Si_2O_7 为基本单元的岛状硅酸盐. $\frac{\sum \text{OR} - N_{\text{OH,F}}}{N_{\text{Si}}} = \frac{2}{\Delta}$

环状硅酸盐: 每个 $[\text{SiO}_4]$ 有两个桥氧. 三、四、六元环. 以环作为基本单元的岛状硅酸盐.

3. $(\frac{\sum \text{OR}}{N_{\text{Si}}} - 3N_{\text{B}} - N_{\text{OH,F}} - N_{\text{Al}}) / N_{\text{Si,Al}} = 2$ N_{Al} 表示 $[\text{Si}^{4+}]$ 的 $[\text{Al}^{3+}]$ 离子数

注：单链与环状的不同之处在于前者化学式Si数量为1或2，而后者是3以上。

层状 { 层原始层：结构可一
组合层：单一原始层或多个不同类型原始层所组成。

层状 从 $(Si_2O_5)^{2-}$ 为重复单元的回面体原始层组成。

层状 { 具有水硅石 [AlOH₃] 层而称：四面体硅酸盐
具有水铝石 [MgOH₂] 层而称：三八面体硅酸盐
如果一个四面体原始层堆在八面体层上，——单层硅酸盐 电荷不对称力，易解离。
如果八面体层两侧都堆有原始四面体层，——双层硅酸盐 层间离子的静电力

骨架状结构硅酸盐

[SiO₄] 四面体单元四个角均相互连接，共顶连接。单链硅酸盐是其典型代表。

单链硅酸盐四面体结构存在 ① 石英 ② 磷石英 ③ 方石英 ④ 柯石英。

其中 ④ 的基本单元为四元环；空内离子进入的通道大小：④ > ②, ③ > ①
此单元是通过对称操作实现的

高分子晶体 { 均聚：结构单元完全一致
共聚：两种以上结构单元混合组成

结晶区域：同一分子不同链段（折叠链晶区）或不同分子某链段（缨集状晶区）

聚乙烯不含任何结晶区域，属非晶型高分子；尼龙6/6 结晶度很高是因为相邻链间含有氢桥。

高分子结晶发生在熔体冷却至熔点以下；形貌为球晶。

第二章 晶体的不完整性

晶点缺陷

一、分类：热缺陷：空位和间隙原子 组或缺陷：掺杂 3 电子缺陷：价态改变；4 非化学计量比结构缺陷

弗伦克尔缺陷：间隙原子和空位成对存在，晶体体积不变

肖特基缺陷：晶体体积增大

热平衡条件下, 缺陷多少仅和晶体所处温度有关. $n/N = \exp(-\frac{\Delta G_f}{kT})$ ΔG_f 一定形成自由能.

替位缺陷: M_x 表示正离子 M 置换了 x 位负离子.

引起位置增强的有: $V_M, V_X, M_M, M_X, X_M, X_i$; 不引起增强的有 e^-, h^+, M_i

- 缺陷平衡方程:
- 1 肖特基缺陷 $\begin{cases} \text{单质 } M_M \leftrightarrow M_M + V_M & [V_M] = \exp(-\frac{\Delta G_f}{kT}) \\ \text{氧化物 } O \leftrightarrow V_M + V_O & [V_M] = [V_O] = \exp(-\frac{\Delta G_f}{2kT}) \end{cases}$
 - 2 弗伦克尔缺陷 $M_M \leftrightarrow M_i + V_M \quad [V_M] = [M_i] = \exp(-\frac{\Delta G_f}{2kT})$
 - AgBr 中弗伦克尔缺陷 $Ag_{Ag} + V_i \leftrightarrow Ag_i + V_{Ag}$

3 组成与电子缺陷

n 型半导体 $P_i \leftrightarrow P_i' + e^-$ p 型: $B_s \leftrightarrow B_s' + h^+$

- 4 非化学计量比
- 金属离子金属离子控制 $TiO_2 \rightarrow TiO_{2-x} \quad ZrO_2 \rightarrow ZrO_{2-x}$ 金属离子提供个空位自由电子, 可导电, n 型半导体
 - 间隙正离子金属离子控制 $Zn_{1+x}O, Cd_{1+x}O$ 过剩电子聚集在间隙位置金属离子周围形成色心. $O_i \leftrightarrow V_O + 2e^- + \frac{1}{2}O_2 \uparrow \quad [V_O] \propto [P_{O_2}]^{1/4}$ TiO_2 非化学计量对氧分压是敏感!
 - 间隙负离子金属离子控制 只有 UO_{2+x} $\frac{1}{2}O_2 \leftrightarrow O_i'' + 2h^+ \quad [O_i''] \propto [P_{O_2}]^{1/2}$ p 型半导体
 - 正离子在, 负离子控制 $Fe_{1-x}O \quad \frac{1}{2}O_2(g) \leftrightarrow O_i + V_{Fe}'' + 2h^+$ 过剩电子或被吸引到空位周围形成 V-色心. 或写成 $2Fe_{Fe} + \frac{1}{2}O_2 \leftrightarrow 2Fe_{Fe}' + O_i + V_{Fe}''$ 正负离子.

与其它缺陷最大不同: 缺陷浓度与气氛性质及大小有关.

计算: $Fe_2O_3 \xrightarrow{\alpha} FeO \leftrightarrow 2Fe_{Fe}' + V_{Fe}'' + 3O_i$ 该反应的平衡常数可表示为: $Fe_{22}^{3+} Fe_{(1-2\alpha-2)}^{2+} O$

若 $Fe^{3+}/Fe^{2+} = \beta$ 则 $\frac{2\alpha}{1-2\alpha-2} = \beta \Rightarrow \alpha = \frac{\beta}{2+3\beta}$ 所以 $x = 2\alpha(1-2\alpha-2) = \frac{2+2\beta}{2+3\beta}$

肖特基缺陷 $N = Hx = \frac{4+5\beta}{2+3\beta}$ 缺陷空位浓度 $\langle V_{Fe}'' \rangle = \alpha = \frac{\beta}{2+3\beta} \Rightarrow$ 空位浓度 $\frac{\langle V_{Fe}'' \rangle}{N}$

所谓色心是由于电子补偿而引起的一种缺陷. 一些晶体经辐照而变色也是由于辐照破坏晶格, 产生各种各样类型自由点缺陷, 这种缺陷晶格缺陷, 即为色心. 色心产生原因: 一定条件下, 为了使缺陷区域保持电中性, 过剩电子或电子空位聚集在缺陷位置, 如原子用电子具有一系列分立的允许能级, 这些能级能

5 被束缚在缺陷位置上, 如原子用电子具有一系列分立的允许能级, 这些能级能相当于可见光谱区域的电子能级. 因而能吸收一定波长的光, 使材料呈现出颜色.

F-色心: 一个负离子空位和一个在此位置上的电子组成 F-色心: 捕获 1 个这样的电子 $e^- | V_O''$

S_2 位错 {刃型, 螺型, 混合型} 特殊情况产生
 平面位错 螺型位错
 螺旋位错: 螺型位错

1. 刃型位错: 把原子层排号重列, 丢掉正常相邻的原子区域称为位错核心, 核心是一个窄形区域。引起形变或压缩变形, 形成剪切变形。

2. 螺型位错: 只引起剪切变形, 不引起膨胀和压缩。表面露头处有一台阶, 起到晶体生长溶解的作用, 台阶永不消失。均匀质中, 台阶为螺型位错线速度相同, 角速度不同(正负螺端大于正负螺端), 故台阶变为螺旋状, 称扭折螺旋线。

3. 柏格斯回路: 取含有位错的实际晶体, 从各正位原子出发, 绕在螺型一周后回路, 回路终点在始点, 即为柏格斯回路。柏格斯矢量: 在完整晶体中相同方向走同样多的步数, 为使回路闭合, 从终点到始点补一个矢量量。

4. 柏格斯矢量是位错最根本的特征。

5. 应力分量 9个, 其中 3个正应力, 6个切应力 τ_{xy} τ_{yz} τ_{zx} (外法线指向 yz 平面)

6. 螺型位错应力场特点: 只有切应力分量, 没有正应力分量; 应力分量是轴对称的; 应力大小与位错线的距离成反比。

7. 位错能量 分两部分: ①核心的能量 (= 取左右应变能) ②核心外能量即应变能

8. 单位长度刃位错应变能 $E_e = \frac{2b^2 \mu}{4\pi(1-\nu)} \ln\left(\frac{R}{r_c}\right)$ } 位错应变能与 b^2 成正比; 刃应变能比螺应变能大 50%。

单位长度螺位错应变能 $E_s = \frac{2b^2 \mu}{4\pi} \ln\left(\frac{R}{r_c}\right)$
 混合位错应变能 $b_s = b \cos \theta$ $b_c = b \sin \theta$ 分别将 b_c 和 b_s 代入 E_e 和 E_s 。

9. 相互平行的刃型位错和螺型位错无共同的应力分量, 所以它们之间无相互作用能。

10. 位错线张力: 位错线长度增加一个单位时, 所需能量的增加。直线型: $T = \mu b^2$, 一般将柏格斯矢计 $T = \frac{1}{2} \mu b^2$

11. 派-纳模型: 假设晶体由被滑移面隔开的两个半晶体组成, 在两个半晶体的衔接处直接考虑原子间相互作用, 但两个晶体内部仍按弹性或连续弹性性质。

12. 原子错排 $\geq 1/4$ 的区域称位错宽度 w , 位错宽度标志着位错畸变集中程度。

13. 密排面间距大, 相邻晶面原子对挤压力弱, 所以位错有较大宽度。

14. 派-纳模型的能量 ①上下两半晶体中的弹性应变能; ②滑移面两侧的原子间错排能 (相当于核心能)

15. 相同切应力下 正负刃位错移动方向相反, 但所造成之晶体畸变是完全相同的。

16. 螺型位错与刃位错滑移结果是相同的。

17. 只有当切应力作用在一层螺位错面上, 并且平行于它的柏氏矢量方向时, 才有这种位错越层运动。

6. 构成驱动力原因 既外力, 又可是内部应力。

18 驱动力 $F = \tau b$ 。其中 τ 为沿柏氏矢量切应力分量。作用：引起滑移，克服障碍和产生速度。

19 点阵阻力：来源于晶格结构的周期性。
克服点阵阻力，要有位错前进必须克服滑移力，和对应的切应力 τ_p ， τ_p 称为派纳内应力。

$$\tau_p = \frac{2\gamma}{(1-\nu)} \exp(-2\pi w/b)$$

经验公式：① $b \downarrow$, $\tau_p \downarrow$ ，说明 b 小的位错易滑移

② $w \uparrow$, $\tau_p \downarrow$ ，说明密排面容易有位错线，也说明了刃位错有良好的塑性变形和离子晶体脆。

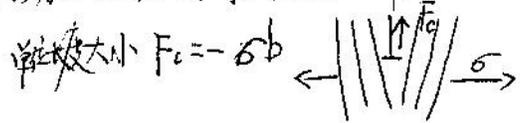
20 攀移比滑移需要更大能量。攀移称“非守恒运动”，滑移称“守恒运动”。

21 高应力：原子附着或脱离多余半原子面可能性最大的地方。

22 正应力有利于攀移，其中压应力促进正攀移。② 饱和空位有利于攀移。

23 驱动力：过饱和空位引起。 $F_s = \frac{1}{2} kT \ln \frac{c}{c_0}$ 。 c - 实际浓度 c_0 - 平衡浓度

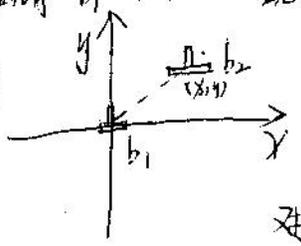
弹性攀移力：刃位在向上攀移，多余半原子面缩小，引起晶格收缩；反之... 正刃位错向上攀移



24 攀移速度：受扩散速度、攀移速度、空位扩散速度制约。

25 平行刃型位错： b_1 应力场 $\sigma = \frac{\tau b_1}{2\pi r}$ b_2 应力 $F = \frac{\tau b_1 b_2}{2\pi r}$ 同号相斥 异号相吸

26 同号平行的刃型位错



b_1 应力分量一个使 b_2 滑移 (x轴)，一个使 b_2 攀移 (y轴)。

F 与 y 同号，即 y 轴方向上刃型位错排斥；

每滑移力 F_x ① 当 $x > y$ 刃型位错在轴排斥；② $x < y$ 相互吸引

③ $x = 0$ $F = 0$ 稳定平衡位置 ④ $x \neq y$, $F = 0$ 不稳定平衡位置

当同号刃型位错沿着与它们的柏氏矢量垂直的方向排列时稳定。

若为异号，则 $x = 0$ 为不稳定平衡状态； $x \neq y$ 为稳定平衡状态。

符号相反的两个位错靠弹性作用在 x 方向上结合在一起，构成位错偶极子。

27 平行的纯螺位错与纯刃位错没有相互作用。

28 柏氏矢量夹角 $< \pi/2$ ，排斥。 $> \pi/2$ ，吸引。

29 位错密度群长度正比于 N ，反比于 τ 。一个主要效应：为滑移力 τ ，为滑切力 $\tau = n\tau$ ，其中 τ 为外加切应力。

晶粒应力集中导致相邻晶粒屈服，也可能引起裂纹。

30 位错：对于滑移面上运动位错来说，穿过其滑移面的其它位错。

31 一般情况下，两位错交割时，每个位错都产生一段位错，它们的柏氏矢量与原始位错的柏氏矢量相同，大小与方向决定于另一位错的柏氏矢量。当位错以相反方向不在所属位错滑移面时，叫位错交割；若在滑移面时叫位错扭折。

32 亚刃位错滑移面上位错体积小，吸引小量原子或空位；下位错大，吸引间隙原子或大量原子。

33 { 柯垂尔区：由于溶质原子与位错有相互作用，若速度足够快，它们将向位错附近聚集，形成区团。
艾舍尔区：位错周围溶质原子在x, y, z三种面心位置上发生择优分布，使整个系统能量降低，叫做艾舍尔区。
位错有序：这种相互作用叫做艾舍尔区。

34 膨胀侧电子浓度高，带负电；压缩侧浓度低，带正电，从而整个位错成为线状电偶极子。

35 平衡状态下位错周围原子浓度 $C = C_0 \exp(-\frac{U}{kT})$ U为位错与溶质原子相互作用能。

36 晶界附近不易形成位错环：因为位错和空位可流到晶界并在那里消亡。

37 位错来源：
 ① 过饱和空位聚集或空位片，空位片崩塌成为位错环；
 ② 结晶时杂质析出或成分偏析显著；
 ③ 从表面向晶体扩散另一种元素；
 ④ 溶质或杂质在周围基体中产生较大应力；
 ⑤ 结晶时正在生长的不同晶体相遇，在方向有轻微差异；
 ⑥ 晶体变形，局部地区应力集中，若程度达到理论切变强度水平，则可能直接产生位错。

38 F-R源 $v = \frac{ub}{2R}$ R为曲率半径 开动的临界条件 $v_c = ub/l$ l一位错长度

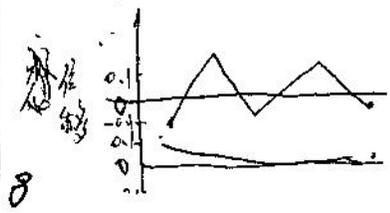
39 单点源：可滑动的位错只有一端被固定，在切应力下将形成螺线并绕固定点转动。

§3 表面力 (本质静电)：来自于表面不饱和价键
 表面力 (表面张力) 的键力：
 ① 吸引力 (范德瓦耳力) 定向作用：极性分子之间，有一恒定电矩(电)，本质为静电力
 ② 诱导作用：极性分子与非极性分子之间。诱导是在极性分子作用下非极性分子被极化，诱导一暂时极化电矩。
 ③ 色散作用：非极性分子之间。电子绕核运动某一瞬间，各个位置上电子分布并非严格相同，将呈现出瞬间的极化电矩。

1 表面双电层：表面负离子被拉向外侧，正离子被拉向内侧，表面层中离子间键键性逐渐过渡为共价键性。

2 极化性能越大 (表面能就越大)，键键性就越小，表面双电层厚度就越大。

3 负离子总趋向外移，正离子总向内移，第二层向外，依次交替，离子间距交替增减和变化。如图所标示



4 表面单位面积自由能所增加叫表面能 $\gamma (J/m^2)$

① $\gamma = \frac{dW}{dS}$ (单位表面功)

② 大小 = 表面张力 (单位长度的)

5. 晶格结构的晶表面分两类: ① 紧密堆积的表面; ② 不紧密堆积表面 (台阶式表面)

6. 晶面暴露在外表面是一类低表面能的晶面。

7. 二维点阵两个自由度, 三维 5 个自由度

8. 大角度晶界在各晶金属材料中 $30^\circ - 40^\circ$, 小角度 $\leq 2^\circ$ 中的亚晶界 $\leq 2^\circ$ 。

9. 扭折晶界: 一种小角度晶界, 1 个自由度, 由螺旋型位错交叉网络构成。

10. 大角度晶界: 重合点阵。重合位置密度: 重合位置点晶体/原子点阵数
晶界为求重合位置点阵的晶面重合。

11. 大角度的晶界能与位向差无关, 大约为定值, 而小角度有关。

$$12. \gamma_{12}/\sin \varphi_3 = \gamma_{23}/\sin \varphi_1 = \frac{\gamma_{31}}{\sin \varphi_2} \quad (\varphi = 120^\circ \text{ 最稳定})$$

13. 孪晶界: 最简单的晶界, 呈镜面对称关系。孪晶面=孪晶界的为共格孪晶界; 不然叫做非共格孪晶界。

14. 面心立方各晶面 $\{111\}$, 体心立方各晶面 $\{112\}$ 。

15. 金属下: 晶界处有较高强度和硬度; 高温下作用相反。

16. 晶界原子扩散快, 故熔点低, 所以熔化首先从晶界开始。内吸附: 掺入的元素时往往富集于晶界处。

第三章 固溶体

1. 超结构: 由短程有序变为长程有序直到晶胞中相当大范围内溶质原子有序排列时。

2. 休姆-波德里规律

① 15% 规律; ② 金属的混合熵 (中间相) 的形成与组元化学亲和力有关。亲和力愈大, 自由能愈小, 熵变愈小。

③ 电子浓度: 价电子数/原子数。相对价数: 高价在合金中中国溶度大于低价在高价中国溶度。

(该效应只适用于某些合金系) 条件:

3. 确定一固溶度三个侧面: 尺寸因素、化学亲和力因素、电子浓度因素。

4. 离子键特征的中间相, 化学亲和力因素起较大作用; 金属键 \rightarrow 电子浓度因素起较大作用。

5. 维也定律: $a = a_1 + (a_2 - a_1)x$ a_2 是溶质, x 是溶质浓度。

6. 点阵畸变可用原子的“静位移”估计。原胞中心与其点阵位置之差称静位移。

平均静位移: 用原子静位移的均方根 $\sqrt{\overline{r^2}}$ 表示。

7. 15% 规律主要针对金属合金用溶质。对无机非金属材料用键长半径代替原子半径; 而用键长更合理。

8. 层状型 ABC₃ 最紧密堆积时 $r_A + r_C = \sqrt{2}(r_B + r_C)$ 。实际上 $r_A + r_C = t\sqrt{2}(r_B + r_C)$ t 称为宽容系数

9 溶质元素原子价越高,溶解度越小。

10 过渡族元素应用“平均族数”概念。族数: 满壳层外的(s+p+d)电子数。金属平均族数按元素原子百分数乘以其族数求平均值。

11 离子晶体离子价相同或离子半径和相同才能生成连续固溶体,是必要條件。

12 最早的压电陶瓷 BaTiO₃ 根本

13 不等价取代只能生成有限固溶体的原因: 生成固溶体时,为了保持电中性,必须在基体中产生空位。

14 也有认为对金属来说电负性差 $\Delta \chi = 0.4$ 是溶解度的一个边界。大于就难以形成固溶体。

15 弗伦杰尔关系: 在二元系统中,中间化合物的数目与场强 $\propto \frac{z}{d^2}$ 成正比。
场强用 $\frac{z}{d^2}$ 表示 z 是正离子价数, d 是原子之间距离。

16 S₂

1 在金属的物质中,间隙固溶体很普遍。金属中,一般形成间隙固溶体的溶质元素是原子半径小于 1Å 的一些非金属元素。

2 C 原子在八面体中处在八面体间隙中,因为 C 原子挤入时主要推升最靠近的上下两个铁原子,这要比挤入四面体间隙要推开四个铁原子更容易。

3 有序固溶体: 即为超结构,从某些方面看,更接近于中间相。

4 三种分布情况: ① 无序分布 ② 有序分布 ③ 短程有序分布

5 有序度参数: $\alpha_2 = 1 - \frac{n_2}{m_A c_i}$ n_2 为 A 原子层数 m_A 金属中 A 的原子数 c_i 一 i 层上下层原子数
A、B 为原子数, m 同心圆

6 有序度随浓度提高而连续增加,达到数值,然后连续下降。

7 有序: 金属冷却到临界温度 T_c 时,小原子群相互合并吸收邻近无序的原子形成,瞬间完全有序,瞬间原子解群。

8 温度低于 T_c 时,有序不再稳定,由长程有序变为短程有序,但只有在慢速冷却才能达到完全有序。

9 P₄₀ 例题

10 金属间化合物: 在中间相稳定的整个浓度范围内都显示中长相有序的中间相。

11 如果化合物是离子化合物它应遵守半径比,在二元相图上表现出垂直线,二元化合物金属;

典型金属间化合物合金中,中间相溶解度范围较宽。

12 中间相 { 正常化合物: 服从原子价规律
电子化合物: 又叫电子相。决定于电子浓度 21/14 21/13 21/12
间隙相和间隙化合物: 小尺寸原子与过渡金属之间形成。A、B 电负性差大,且 $\Delta r \geq 41\%$ 时,容易形成中间相。AB, A₃B, A₂B, A
30% < Δr < 41% 形成间隙化合物; 为碳化物; 具有金属晶体结构
10 结构相: 大小不同的原子构成具有较高空间利用率和有配位数。配位数可达 12, 14, 15, 16。正价相 (fcc, hcp): 最

7. 四面体键合的做结构: 次近邻12个原子, 次近邻距为最近邻距的 $\sqrt{3} \left(\frac{2}{3}\right)$ 角 $\alpha \sim 60^\circ$ 连续分布。

不只存在1种原子环, 最可能的是6原子环, 其他依次为5、7、8原子环。 $\rightarrow = \frac{1}{a}$

8 III-V族 结构中不存在奇数原子环, 小四面体单元, 比如砷、硅情况更复杂。

9 硫系: 包括 S, Se, Te 及其合金或化合物。二配位链状或环状。混合配位: 链或层状 α -As₂Se₃

10 α -Si: H 是种用激光方法控制制备薄膜。键H区“岛状结构”, 空H区“网络组织”

§3 非晶态金属

球状堆积模型: (目前公认的最好模型) 结构中不包含可容纳在球下间隙。堆积层或层序有两种结构组织:

① Bernal 空洞 (5种): 相邻球的球心连线为棱所构成的多面体, 每个面均为三角形。

② Voronoi 多面体: 平均面数 14.25 ± 0.015 , 平均边数 5.158 ± 0.003 。

对过渡金属-金属非晶合金提出另一模型—三棱柱多面体。两个三棱柱具有一个公用边, 新增一个棱柱长需增加7个原子即可。

非晶态金属: ① Bernal 空洞: 晶态仅有两种四面体, 正四面体; ② Voronoi 多面体: 在面心立方和 hcp 中又有四边在 bcc 跨四边四面体和六边四面体。

做模型: 理论与实验符合得不是很好。晶态密度比晶态的密, 因为按模型, 非晶态间必存在大角晶界, 使密度降低。

非晶团模型: 非晶团是晶态上高度有序的低能原子团, 非晶态即由许多非晶团无规则排列组成。

1. 非晶态金属做结构: 结构涨落, 形貌起伏。分为两类:

(1) 做结构: 密度涨落, 形貌起伏, 连续分布。

(2) 做结构: 成分不均匀, 原子聚集, 指向有序化。

2. 与晶态比较 非晶态金属各向异性特点: ① 比晶态密 ② 在生长是单轴各向异性, 只有个易轴方向; ③ 大小和易轴方向一致是各处位置连续函数 ④ 热力学性质显著 ⑤ 各向异性的

§4 玻璃

1 理论是建立在(正规)网络学说和微原子学说基础上。

2 对氧化物玻璃, 形成连续空间网络, 要求四面体至少有三个顶角与相邻四面体共用。

3 P169 图 4-24

网络形成剂: V_2O_5 , As_2O_3 , Sb_2O_3 ② 网络改性剂: ③ 中间剂 Al_2O_3 , TiO_2 (配位数有4有6)

5 做 晶子学说: 认为它不同与做晶, 是有点序变形的有序排列分散在无定形介质中, 且从晶子到无定形区过渡是逐步完成的, 无明显界限。
传统说: 玻璃由做晶与无定形物质组成, 两部分有明显界限, 长期无定形是由于做晶有序, 不连续。
现代理论: 做晶子是晶格极不完整, 有序区域极微小晶体。一种做晶通过中间层逐渐过渡到另种。

6. 玻璃网络学说着重于玻璃结构的无序、连续、均匀、统计性；

玻质子学说强调玻璃结构的微不均匀和有序性

两者统一看法：玻璃具有近程有序，远程无序的结构。但在比例问题上仍有分歧。

7. 加入 $RO \cdot R_2O$ 直到 $SiO_2 [RO(R_2O) = 1:1]$ ，网络仍存在； $2:1$ 以后，网络破坏严重。

加入 $RO \cdot R_2O$ 越多，玻璃的析晶化速率也越快，形成玻璃越困难。

范围内二硅酸盐 ($R_2O \cdot 2SiO_2$ 或 $RO \cdot 2SiO_2$) 和单硅酸盐 ($R_2O \cdot SiO_2$ 或 $RO \cdot SiO_2$) 之间可能

以链状结构存在，超过单硅酸盐，主要结构单元环状、链状硅四面体。

8. 三元玻璃 $Na_2O-CaO-SiO_2$ 中， Na_2O 是助熔剂 $12\% - 18\%$ ， CaO 显著改善玻璃性能 $6\% - 9\%$ 。

SiO_2 $65\% - 75\%$

9. $Na_2O:Al_2O_3 \geq 1$ 时，铝形成四面体 $[AlO_4]$ 是网络形成剂； < 1 时，部分 Al^{3+} 保留为 AlO_3 在玻璃网络边缘

10. X —平均非桥氧数 Y —桥氧数 Z —包圍一种网络形成剂的非氧原子数 (3或4) R —金属离子与网络形成剂

$$X + Y = Z \quad X + \frac{1}{2}Y = R$$

11. 当 $Y < 2$ 时，硅酸盐玻璃不可能形成三维网络。

12. 过渡离子 $Co^{2+}, Ni^{2+}, Pb^{2+}$ 实际并非列入网络边缘剂，计算的 Y 值要比实际的 Y 值小。

13. 当加 Pb^{2+} 使 $Y < 2$ 时，结构柔性没降低，反而加固了玻璃的结构。这是因为 Pb^{2+} 不仅只是通常认为的

改变离子，由于其可极化性很大，在玻璃玻璃中， Pb^{2+} 可能让 SiO_2 以分立的 $[SiO_4]$ 单元沉浸在它的电子云中间，保持了较高的内聚力，这种玻璃称“逆玻璃”或“反向玻璃”。

14. 磷酸玻璃：
① 低温时层状结构 (磷酸链和磷酸三元环形成的向两端延伸发展的网络) 三角环内 $B-O-B$ 120° ，环外 $B-O-B$
② 较高高温链状结构 (两个磷酸在两个顶角上相连接)
③ 高温 (蒸汽)：一对三角形为共用三角，成为双链体。

15. 在 B_2O_3 中加 P^{2+} ；开始时，非但不破坏桥氧，反而会加固网络， Y 不变小而是增加，这是因为 R_2O 给出了桥氧，使一部分硼变成 $[BO_4]$ 。再加 RO (R_2O 含量 $> 30\%$)，不能增加 $[BO_4]$ 数，而是破坏桥氧，打断网络，形成非桥氧，这时 Y 值随 R_2O 含量增加而下降。

16. $[BO_4]$ 四面体的四个键中有两个成双键， $P-O-P$ 键角为约 115° 。

17. 磷氧 (P_2O_5) 玻璃结构是由分子 P_4O_{10} 所组成，分子间由范德瓦耳斯力连接。

18. 二元碱磷酸盐和二元碱硅酸盐两个共同点：① 结构单元都是四面体；② 加入修饰物都破坏了网络

19. 玻璃转变温度及上限： T_g —膨胀系数温度 ($\beta = 10^{24} Pa \cdot s$) T_g —转变温度 ($\beta = 10^{12.4} Pa \cdot s$)

20 P176 图4-32

21 $T_g - T_f$ 温度区间的大小决定于玻璃副组成。

22 玻璃的低温性能落后于温度。这一区域的长度范围相当于 $10^{12} - 10^{13.5}$ 秒，这个温度区间一般称为退火区域。(在 T_g 以下)

23 当玻璃冷却到室温时，它保持着 $T_f - T_g$ 范围内某一温度相态的平衡结构状态和性能。这一温度叫“假想温度”。

24 ① 转变温度范围内，温度越低，结构达到平衡所需的时间越长，即滞后时间越长；
② 冷却速度越快，结构可用来平衡的时间越短，则假想温度越高。

25 玻璃能稳定存在是由动力学条件决定的。析晶带在假能垒。

26 生成玻璃的关键是熔体的冷却速度(即冷却增大速度)。熔体数量大则冷却速度小。

27 3T图：玻璃形成物及形成玻璃能力大小。玻璃形成物最小晶核体积与熔体之比大约为 10^6 (体积分数)

28 在时间 t 内单位体积的结晶 $V_c/V = \frac{2}{3} I_n U t^3$ I_n - 单位时间成核数目, U - 晶核生长速度。

29 临界冷却速度: $(dt/dt)_c \approx \frac{\Delta T_m}{Z_m}$ $\Delta T_m = T_m - T_n$ (T_n 为鼻尖的温度) Z_m - 鼻尖的时间。

30 ① 在凝固点(热力学熔点 T_m) 附近的熔体粘度的大小, 是决定是否形成玻璃的关键。
② 具有较低熔点即 T_g/T_m 较大, 玻璃态易于获得。

31 结晶条件: ① 阴离子团。如果和熔体中阳离子团是低聚合的, 不易形成玻璃。但大小不是决定是否形成玻璃的关键。
② 化学键。单纯的键合不易形成玻璃, 尤其金属键不易。但当形成混合键时, 易形成玻璃。

eg 极性共价键化合物较易形成玻璃。

单键强度(即 $M-O$ 键解离能除以阴离子 M 的配位数)可衡量生成玻璃的能力:
> 80 Kcal/mol - 玻璃形成倾向物 eg $CaCl_2$; < 60 Kcal/mol, 玻璃调整剂;
60 ~ 80 Kcal/mol 中间体化合物 BeO, ZnO

阳离子场强 (Z/r^2) > 1.8 网络形成体 < 0.8 网络修饰剂 0.8 ~ 1.8 中间体化合物

St 高分子非晶态熵: 玻璃态、高弹态, 结晶高分子中的非结晶部分, 粒流态。

St 的线团模型: 理论基础是高分子溶液理论。一很好解释橡胶弹性问题, 自由体积。

局部有序模型: 有序排列的折叠链模型求粒子模型。非晶态由折叠链构成的“粒子团”和“无规线团”构成的粒子团。

1 玻璃化转变: 非晶态高分子玻璃态与高弹态之间的转变。

2 体积膨胀系数 又为体积对温度的导数与体积之比 $\alpha = \frac{1}{V} \frac{dV}{dT}$ 膨胀率

3 较好理论: 华莱士的“自由体积理论”。当玻璃化转变温度时, 自由体积达到最低值, 在玻璃态下, 维持一定

4 P185 计算 对玻璃化转变

→ 转变温度

5 自由体积: 在玻璃态自由体积不随温度变化, 对高弹态自由体积与温度是个定值, 玻璃态时, T_g 随压力增加而升高, T_g 升高

第五章 扩散现象：原子迁移的微观化过程，及由此引起的宏观现象。

§1. 扩散现象：原子不断地由一处向另一处作无规则的布朗运动。

1. 稳态扩散 $(\frac{\partial C}{\partial t}) = 0$, 则 $\frac{\partial J}{\partial x} = 0$ D 是浓度的函数, 只有当浓度很小时, D 才是常数。

2. 透气率：压力差 ΔP 为 1 mmHg 下, 每分钟通过 1 mm 厚, 截面 A 为 1 cm² 玻璃的气体体积 (cm³)

3. 气体通过玻璃的渗透率 K 和扩散系数 D 会随玻璃中网络形成体含量增大而增大; 反之, 随玻璃中网络形成体含量的增加, 或网络外正离子 R^+ , K^+ 离子半径增大而降低。

4. 非稳态扩散 $(\frac{\partial C}{\partial t}) = -(\frac{\partial J}{\partial x}) = \frac{\partial}{\partial x} (D \frac{\partial C}{\partial x})$

5. $C = A \sqrt{Dt} \int_0^{\beta} \exp(-\beta^2) d\beta + B$ 其中 $\beta = \frac{x}{\sqrt{Dt}}$ 定义误差函数 $\text{erf}(\beta) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\beta} \exp(-\beta^2) d\beta$

$\text{erf}(-\beta) = -\text{erf}(\beta)$ $\text{erf}(0) = 0$ $\text{erf}(+\infty) = 1$

6. 硼在硅片中扩散实验结果大于计算结果, 原因是: 表面硼浓度未达到饱和浓度, 而且硼渗入硅后形成载流子空穴, 后者迁移较快, 离开了硼原子在硼网造成十电场, 从而加速了硼的扩散。

7. $\Gamma = Z \nu v \omega$ 对 FCC $Z=12$ $a = \frac{\sqrt{2}}{2} a_0$; 对根稀薄 FCC 间隙用液体 $\nu = 1$, $D = a_0^2 \nu \exp(-\frac{\Delta G_m}{RT})$ ν 为间隙原子

上述还适用于一般晶格的空位扩散。

8. 自扩散: 不受浓度梯度的扩散。自扩散系数 $D^* = \lim_{(C \rightarrow 0)} [\frac{J}{\partial C / \partial x}]$

化学扩散或互扩散: 依赖于浓度梯度的扩散。

9. 非理想溶液的自扩散系数 $D_i = D_i^* (1 + \frac{\partial \ln \gamma_i}{\partial \ln C_i})$ 括号部分为扩散系数的热力学因子 $\gamma_i = C_0 / C_i$

D_i^* 为理想溶液的扩散系数或为组成元素 * 的自扩散系数。 $D_i^* = B_i kT$ B_i 绝对速率: 单位时间内能克服的能垒 $= R/N_i$ 自扩散

对二元系 $\frac{\partial \ln \gamma_1}{\partial \ln C_1} = \frac{\partial \ln \gamma_2}{\partial \ln C_2}$

10. 在黄铜 (Cu + 30% Zn) 棒表面上镀细的铜丝, 再在黄铜上电镀纯铜, 由于 $|J_{Zn}| < |J_{Cu}|$, $D_{Zn} > D_{Cu}$, 使铜丝移动, 铜

支撑空位机构, 有瓦根达尔效应的合金中, 是不可能采用交换机构进行原子迁移的。

11. 铜丝移动速度 $V = \frac{1}{C} (D_1 \frac{\partial C_1}{\partial x} + D_2 \frac{\partial C_2}{\partial x}) = D_1 \frac{\partial N_1}{\partial x} + D_2 \frac{\partial N_2}{\partial x}$ $\tilde{D} = N_2 D_1 + N_1 D_2$ 前提是 $\frac{\partial C}{\partial t} = 0$

通用公式: $V = (D_2 - D_1) \frac{\partial N_2}{\partial x}$ $V = (D_1 - D_2) \frac{\partial N_1}{\partial x}$

12. 对铜丝移动: $J_{Cu} = -\tilde{D} (\frac{\partial C_1}{\partial x})$ $J_{Zn} = -\tilde{D} (\frac{\partial C_2}{\partial x})$ 是描述了纯铜的流动和扩散性流动之总和。

13. 原始焊接平面 (S_0), 界面 (S_M): 向两侧扩散物质相同的面, S_I 铜丝表面。

① $\frac{\partial C}{\partial t} = 0$ $D_1 = D_2$ $S_0 = S_M = S_I$ ② $\frac{\partial C}{\partial t} = 0$ $D_1 \neq D_2$ $S_0 = S_M \neq S_I$

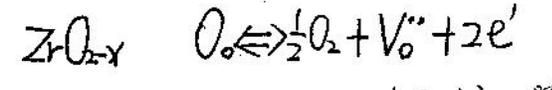
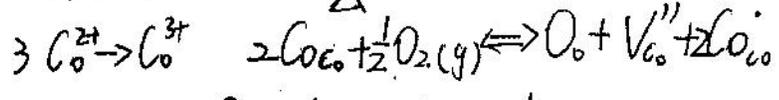
③ $\frac{\partial C}{\partial t} \neq 0$ $D_1 = D_2$ $S_0 \neq S_M = S_I$ ④ $\frac{\partial C}{\partial t} \neq 0$ $D_1 \neq D_2$ $S_0 \neq S_M \neq S_I$ (Cu-Zn 系就是这样的)

14. P_{207} 计算

§2. 实现空位扩散的条件: ① 扩散原子正离子在空位 (2) 金属空位扩散原子具有可以克服势垒的自由能。

1. 扩散的激活能由原子跳动的激活能和空位形成能两部分组成。置换扩散属于空位扩散机制。

2. 间隙扩散：对bcc $Z \geq 4$ $a = \frac{1}{2}a_0$



4. 金属或非金属扩散：速率由杂质决定。随温度升高，产生热缺陷，这时杂质扩散可以转变为本征扩散。

5. 金属原子物 (eg ZrO_{2-x}) 扩散机制三种：①低温区，间隙浓度由杂质决定。 $\ln D \sim \frac{1}{T}$ 斜率 $\Delta E/k$

②中温区 $(\Delta E_{fb} + \Delta E)/k$ ③高温区，本征扩散 $(\Delta E_{fb} + \Delta E)/k$

6. 铜 (fcc) 中的扩散系数大于黄铜 (fcc)；同物质在晶体中扩散系数比在玻璃或熔体中几个数量级

7. 间隙型固溶体比置换型容易扩散，因为前者在扩散中无需消耗形成空位功，降低了扩散活化能。

8. 金属固溶体扩散激活能与熔点 T_m 成正比一常量。铅合金中，扩散元素与铅在周期表中位置相隔愈远，激活能愈大。

9. 均匀晶体中引入第三组元，导致晶格畸变，扩散系数增大，比非晶态化合物更明显。若有缺陷，则有附加驱动力，扩散系数下降。

10. 合金元素对碳在 $\gamma-Fe$ 中扩散系数的影响：①形成碳化物， $D \downarrow$ eg W, Mo, Cr ②溶于碳化物 D 则不大 eg Mn

③溶于固溶体中的元素影响各不相同。Co, Ni使 $D \uparrow$ ；Si使 $D \downarrow$

11. 沿界面扩散通量 $J = -D \int_{f_c} \frac{dc}{dx}$ f_c 扩散界面点面积的有效分数。在低温度时，才观察到。

刃型位错会显著加速扩散。对于置换固溶体亦如是，晶界扩散的激活能仅为晶内扩散一半。

12. 晶界扩散有些反常，一种离子优先扩散，这与晶界电荷有关，与电荷相同符号的离子优先扩散。

13. 离子电导率与离子电导有密切关系。爱因斯坦公式 $\sigma/D = q^2 C/kT$ q 电量 C 载流子浓度 σ 电导 $k = R/N_A$

电导率与自扩散系数都随温度呈指数关系增加，而且指数因子中指数值相等。

实际计算会有偏差原因是①可能存在参与扩散，但不参与导电的中性复合体。②外电场与均匀电荷载流子有效电场有

①导致 $\sigma/D < q^2 C/kT$ ；②晶界扩散导致 $\sigma/D > q^2 C/kT$

第六章 晶格振动的量子化

1. 声子：晶格振动的能量量子 $\hbar\omega$ 。其中 ω 是振动模式的角频率。

2. 一维： $\chi_{11} = A e^{i(\kappa x - \omega t)}$ $\lambda = 2\pi/q$ 波矢 $q = n \cdot \frac{2\pi}{a}$ 波速 $v_g = \omega/q$ 单位 $dy/dx/cm$ $v = \frac{mV}{mH}$

$\omega = \frac{2\beta}{m} [1 - \cos(\beta a)]$ 即 $\omega = 2 \left(\frac{\beta}{m}\right)^{1/2} \left| \sin \frac{\beta a}{2} \right|$ —— 一维晶格的色散关系。 (为恢复常数)

3. 一维双原子链： $\omega_1^2 = \frac{\beta}{mM} \{ (m+M) - [m^2 + M^2 + 2mM \cos(2\beta a)]^{1/2} \}$ $2\beta a \in (-\pi, \pi)$ $(\omega_1)_{max} = \left(\frac{2\beta}{m}\right)^{1/2}$

$\omega_2^2 = \frac{\beta}{mM} \{ (m+M) + [m^2 + M^2 + 2mM \cos(2\beta a)]^{1/2} \}$ $(\omega_2)_{min} = \left(\frac{2\beta}{M}\right)^{1/2}$

ω_2 支的格波要用光激发，红外支格波(红外光波)； ω_1 声学波：可以用高频超声波激发。

④对于声学波，当波长相当 λ 时，代表原胞质心的振动；对光学波，当波长很长时，代表原胞内各原子相对振动。

古波恩——把边界对内部原子的影响考虑成一个周期性边界条件，即设想一个由 N 个原胞组成的 N 维原子

其第一个原胞的原子与第 $N+1$ 个原胞的原子振动情况相同。求得 $e^{i2\pi N a} = 1$ $q \cdot Na = 2\pi l$ 复式格子 $e^{i2\pi N a} = 1$

7 在三维晶格中, 对一定的波矢 \$q\$, 有 3 支声学波, \$(3n-3)\$ 支光学波。格波波矢 \$q\$ 的数目等于晶胞的数目, 但不等于晶胞中原子数, 后者等于系统的自由度数。
 的一个原胞中的原子数

8. 弹性波相速度 \$v_{弹} = (\text{弹性模量}/\text{线密度})^{1/2} = (2\rho/(n+1))^{1/2} a = v_{声学波}\$

声学波和弹性波完全一样, 可看做连续介质。

9 长光学波又叫极化波。在半波长范围内正离子向同一侧位移, 而负离子向另一侧位移, 使晶格作以宏观观极化。极化引起的宏观场是个纵向场, 它引起纵向位移, 从而提高了纵向频率。长光学波从波下, 频率比大长声学波。

长光学波 极化声子 - 纵光学声子; 长光学横波具有电磁性, 长光学横波声子是电磁声子。

10 格波散射: 声子同原子碰撞; 电子波散射: 电子和声子碰撞; 光波散射: 光子和声子碰撞。

11 固体比热 \$C_v = (\partial E/\partial T)_v\$ \$E = \frac{1}{2} \frac{h\nu}{k}\$ 称为爱因斯坦温度 \$C_v = 3Nk \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{-\theta_E/T}}{(e^{-\theta_E/T} - 1)^2}\$

① 在高温时满足杜隆-珀松定律 \$C_v = 3Nk\$ (与实验符合很好) ② 非简谐振 \$C_v = 3Nk \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 e^{-\theta_E/T}\$ (与实验符合大)

③ 低温时, 绝缘体比热按 \$T^3\$ 趋近于 0, 导体按 \$T\$ 趋近于 0。爱因斯坦模型忽略了各格波的频率差别, 认为所有都为 \$\omega\$; 另外也忽略了声子统计分布。所以从高温光学声子只有少数被激发。

12 德拜模型 \$C_v = (12\pi^4 Nk/5) \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3\$ 德拜频率 \$\theta_D = \frac{h\nu_m}{k}\$ (德拜温度); 温度越低, 德拜频率越高, 德拜模型越好, 德拜模型越好。

13 晶格振动达到热平衡的最主要原因: 声子间相互作用 (微扰项) 存在, 使声子间相互作用的相互作用, 动量守恒, 能量守恒。

14 左边原子固定不动, 右边原子自由振动。若为简谐振动, 则势能曲线为抛物线, 平衡位置与振幅无关, 保持不动; 若实际上势能曲线不是严格抛物线, 左也较陡, 右也较平缓, 随振幅增加, 平衡位置右移。例外与热膨胀就是由势能曲线的不对称性所致。

15 热流密度 \$Q\$ (单位时间内通过单位面积的热量) \$Q = -k \frac{dT}{dx}\$
 \$k = -\frac{1}{3} C_v v\$ \$C\$ - 单位体积热容量 \$v\$ - 声子平均速率 高温 \$k \propto T^{-1}\$ 低温 \$k \propto T^3\$ \$T \rightarrow 0, k = 0\$

若为完整晶体 \$k = -\frac{1}{3} C_v v\$ \$L\$ - 几何长度是声子数 低温下 \$C \propto T^3\$, \$k\$ 按 \$T^3\$ 变化。

16. 禁带宽度 \$E_g = 2|V_n|\$ \$V_n\$ 势场。第一布里渊区: 波矢介于 \$-\pi/a\$ 到 \$\pi/a\$ 之间; 第二布里渊区: \$-\pi/a \sim -2\pi/a\$ 和 \$\pi/a \sim 2\pi/a\$。第一布里渊区 \$-\pi/a \sim \pi/a\$ 范围内表达, 这个对称... 其中有 \$N\$ 个简并态, 容纳 \$2N\$ 个电子。(\$N\$ 为原胞数)

17 坐标空间 - 正格子。状态空间有倒格子所在的空间。倒格子的基矢 \$\vec{b}_1 = 2\pi \frac{\vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{V}\$ \$\vec{b}_2 = 2\pi \frac{\vec{a}_3 \times \vec{a}_1}{V}\$ \$\vec{b}_3 = 2\pi \frac{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{V}\$

① 体心立方基矢 \$\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(-i+j+k)\$ \$\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(i-j+k)\$ \$\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(i+j-k)\$
 倒格子基矢 \$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(j+k)\$ \$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(i+k)\$ \$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(i+j)\$

体心的倒格子是面心立方, 倒格子基矢长度 \$\frac{\sqrt{2}}{a} 2\pi\$
 ② 面心立方基矢 \$\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(j+k)\$ \$\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(i+k)\$ \$\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(i+j)\$ 倒格子基矢 \$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(-i+j+k)\$ \$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(i+j+k)\$

面心立方的倒格子是体心立方, 倒格子基矢长度 \$\frac{\sqrt{3}}{a} 2\pi\$。八面体空隙成为四面体空隙, 这就是金刚石结构 \$Fcc\$。

18 三维与一维 晶带有区别: 三维晶带能量不连续, 一维晶带能量连续。